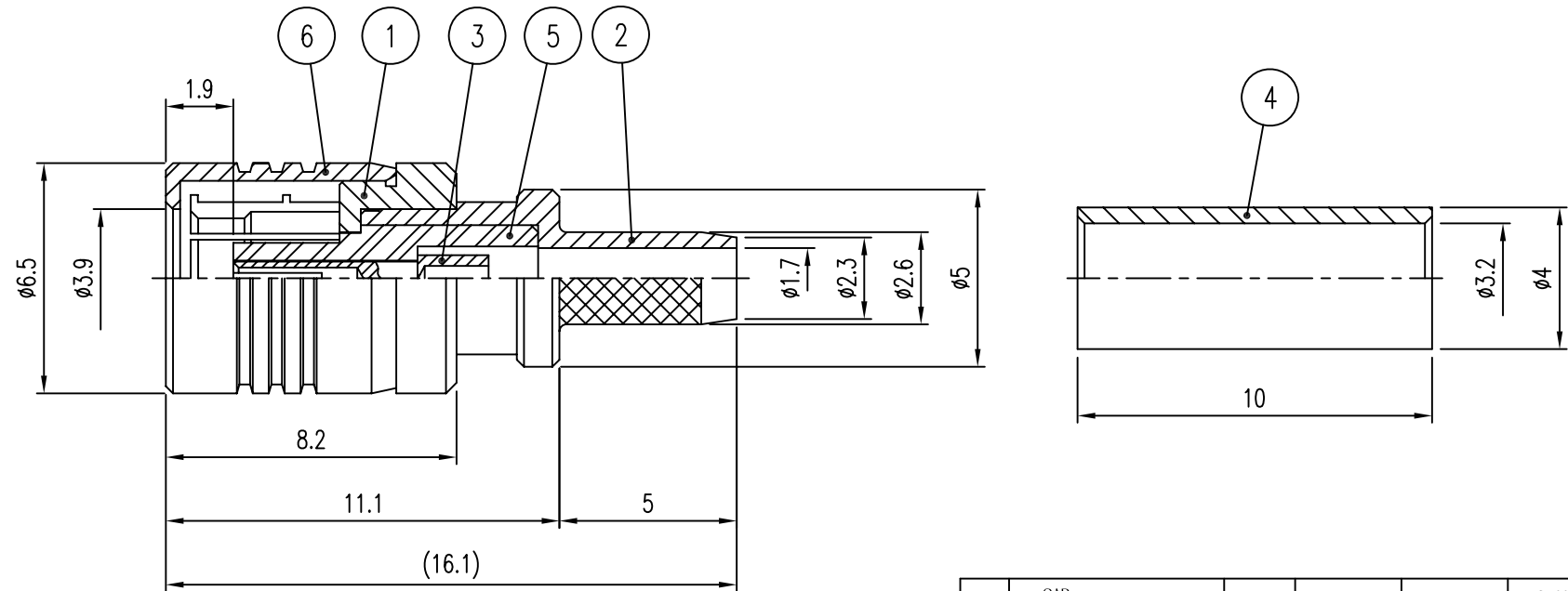


수 정 내 용									
부호	내 용	수정자	승인자	년	월	일			
IR	Initial Registration			2008.	03.	31.			
1	(설번NO.201004-0025) 부착량 개선 BODY(DBD00482) 설번 으로 연번 변경	강동우	최영호	2010.	04.	26.			
2	(설번No.202203-0008) 케미 공용화 부품 적용으로 인해 코드 변경	은선영	김선호	2022.	03.	15.			



6	CAP	1	MBsBD		DCU00021-5/1 (K3001)
5	INSULATOR	1	TEFLON		DIN00346-N/1 (H3001)
4	FERRULE	1	MBsBD	Nickel Plate Gold Plate	DFH00034-5/1 DFH00031-5/1 (E2002)
3	CONTACT	1	BeCu	Gold Plate	DCT00348-5/1 (E3001)
2	BODY	1	MBsBD	Gold Plate	DBD00482-5/2 DBD00482-5/1 (D3070)
1	BODY	1	MBsBD	Gold Plate	DBD00433-5/1 (D3001)

대체가능재질	품번	품 명		수량	재 질	표면처리	비 고
공통공차 * ±0.1 ,** ±0.05	년월일	2022. 03. 15.			 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017 KJ COMTECH CO.,LTD.		
	승인	S.H.KIM					
	재질	검도				도명 SMB-PC-316	
열처리	재도	S.Y.EUN					
보호파막처리	작성부서	연 구 소			A4	도번	CN01736-7/1
	적도 5/1	단위 mm	중량				